

商务部就美国模拟芯片发起反倾销调查 拓荆科技公告增资加码后端设备

——电子行业研究周报



申港证券
SHENGANG SECURITIES

投资摘要:

市场回顾

上周(9.8-9.12)申万电子行业指数上涨 6.15%，在申万 31 个行业中排名第 1，跑赢沪深 300 指数 4.77%。

每周一谈：商务部就美国模拟芯片发起反倾销调查 拓荆科技公告增资加码后端设备

商务部就美国模拟芯片发起反倾销调查，复苏背景下国产替代有望加速。根据商务部和财联社消息，商务部公告对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销调查，涉及自美进口的使用 40nm 及以上工艺制程的通用接口和栅极驱动芯片。申请人提交的初步证据显示，2022-2024 年，申请调查产品自美进口量累计增长 37%，进口价格累计下降 52%，压低和抑制了国内产品销售价格，对国内产业的生产经营造成损害。据江苏省半导体行业协会提交的申请文件，相关美国生产商包括四家，分别是德州仪器、ADI、博通、安森美。初步证据显示，申请调查期内，原产于美国的申请调查产品的价格持续大幅下降，对华出口的倾销幅度高达 300% 以上。Wind 数据显示，德州仪器(TI) 2022-2024 年中国区营收额呈下降趋势，2024 年中国区营收占比 19% 达到 30.12 亿美元。亚德诺(ADI) 2024 年中国区域营收较 2023 年下降 5% 达到 21.29 亿美元，两公司 2024 年合计营收超过 51 亿美元。根据半导体产业纵横及其援引 WSTS 等数据，2024 年全球模拟 IC 市场规模约 794 亿美元，中国市场规模占比近半壁江山。从进口量来看，本次申请调查产品的合计进口数量呈持续大幅上升趋势，2022-2024 年，合计进口数量分别为 11.59、12.99 和 15.90 亿颗，国产替代空间广阔。

与非网 eefocus 数据显示，2024 年中国模拟 IC 市场规模约 1953 亿元，其中 TI 和 ADI 在华营收占比 14.6%，而国内厂商合计仅不足 7%，在车规模模拟 IC 市场差距更为悬殊。近年来国产模拟芯片在 ADC(模数转换器)领域等频频实现技术突破，通过并购整合来完善产品线，积极打造平台化战略。中芯国际 Q2 业绩交流表示，二季度模拟芯片需求增长显著，广泛应用于手机快充、电源管理等领域的模拟芯片正处于国产加速替代阶段。根据半导体产业纵横统计，2025 年上半年模拟芯片行业毛利率整体呈改善态势，行业盈利能力稳步增强，2025 年多数模拟芯片企业的库存周转天数较同期呈现明显的缩短趋势。我们认为，模拟芯片供应链国产化能力较好，市场国内需求广阔，随着国产在车规、工业等中高端市场的点上突破及企业并购整合进程，国产化率有望加速提升。

拓荆科技公告增资拓荆健科，大基金三期同步投资，着力键合等半导体后端设备突破。上周拓荆科技发布公告，为进一步推动控股子公司拓荆健科在三维集成设备领域的迅速发展，联合国投集新等增资拓荆健科不超过 10.395 亿元。拓荆健科主要聚焦三维集成领域先进键合设备(包括混合键合、熔融键合设备)及配套使用的量检测设备，已先后推出了晶圆对晶圆混合键合设备、晶圆对晶圆熔融键合设备、芯片对晶圆键合前表面预处理设备、芯片对晶圆混合键合设备、键合套准精度量测产品、键合套准精度量测设备、永久键合后晶圆激光剥离设备等产品。目前该公司产品已出货至先进存储、逻辑、图像传感器等客户。根据科创板日报，国投集新基金重要出资人为大基金三期，对拓荆健科的投资，

评级

增持(维持)

2025 年 09 月 18 日

王伟

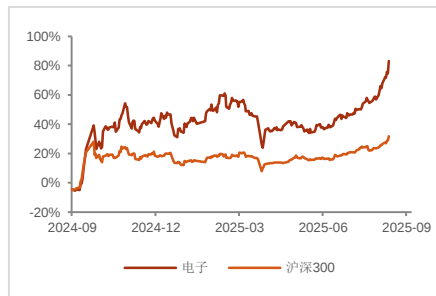
分析师

SAC 执业证书编号: S1660524100001

行业基本资料

股票家数	467
行业平均市盈率	70.6
市场平均市盈率	14.0

行业表现走势图



资料来源: wind, 申港证券研究所

相关报告

- 1、《电子行业研究周报：博通季报指引定制芯片景气提升 先进封装技术有望推动后端设备强劲增长》2025-09-11
- 2、《电子行业研究周报：DeepSeek-V3.1 发布 国产算力迎发展机遇》2025-08-27
- 3、《电子行业研究周报：鸿海展望 Q3 AI 服务器营收高增 智能眼镜出货高景气》2025-08-21

是大基金三期成立至今首度出手半导体产业项目。根据半导体行业观察援引 Yole 数据显示, 2020 全球混合键合设备市场规模达 3.2 亿美元, 预计 2027 年 CoW(D2W)/WoW(W2W) 市场规模将分别攀升至 2.3 亿/5.1 亿美元, CAGR 高达 69%/16%, 凸显该领域强劲增长潜力。

我国半导体设备国产化率相对偏低, 根据 EEPW, 2024 年除去胶设备、清洗设备、刻蚀设备和热处理设备国产化率超 30% 外, PVD/CVD/ALD、CMP、涂胶显影、离子注入、量检测和光刻等环节的国产化率仍低于 20%, 分别为 5-20%、30-40%、5-10%、10-20%、1-10% 和 0-1%。过去国内半导体设备国产化的主要方向聚焦于晶圆制造领域, 目前先进封装等后端设备在芯片制造中扮演的角色日益重要, 根据 PanSemicon 援引 Yole Group 数据, 2025 年后端设备总收入约为 69 亿美元, 预计到 2030 年将增长至 92 亿美元, 复合年增长率为 5.8%, 目前国内供应商仅满足不到 14% 的内部后端设备需求。

我国在键合设备和量检测设备国产化率较低, 我们认为本次增资或助力国产设备在关键环节的突破和提升。

投资策略: 建议关注国产 AI 产业链相关标的寒武纪-U、海光信息、芯原股份、中兴通讯、沪电股份、深南电路、华丰科技、杰华特、中科曙光等; 消费电子及端侧 AI 相关标的立讯精密、蓝思科技、鹏鼎控股、领益智造、东山精密、歌尔股份、环旭电子、瑞芯微、兆易创新等; 半导体设备和零部件、先进制程代工企业中芯国际、华虹半导体、北方华创、拓荆科技、精测电子等; 建议关注有望受益存储上游控产、库存消化及行业供需关系改善逻辑下的模拟芯片、存储模组和端侧存储公司。

风险提示: 贸易摩擦加剧, 需求复苏不及预期, 产能扩张不及预期, 竞争加剧

1. 市场回顾

上周(9.8-9.12)申万电子行业指数上涨 6.15%，在申万 31 个行业中排名第 1，跑赢沪深 300 指数 4.77%。

本月(9.1-9.12)申万电子行业指数上涨 1.30%，在申万 31 个行业中排名第 11，跑赢沪深 300 指数 0.74%。

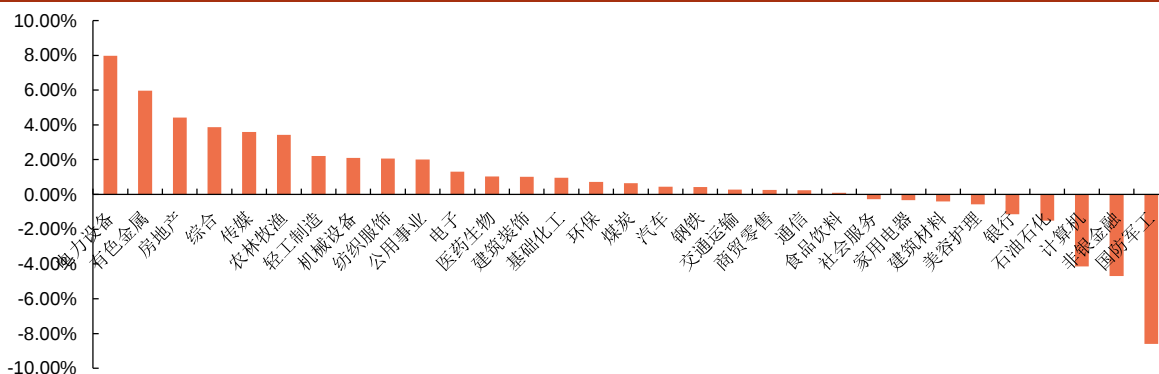
年初至今(1.1-9.12)申万电子行业指数上涨 40.15%，在申万 31 个行业中排名第 4，跑赢沪深 300 指数 25.23%。

图1：申万一级行业上周涨跌幅



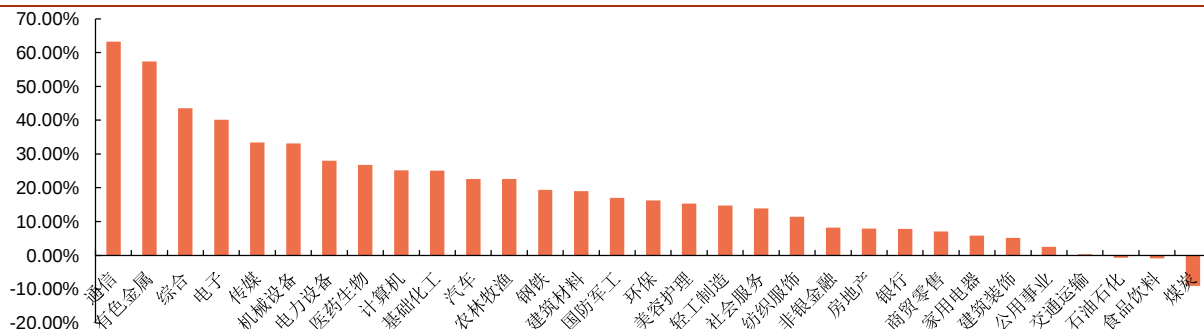
资料来源：wind，申港证券研究所

图2：申万一级行业本月以来涨跌幅



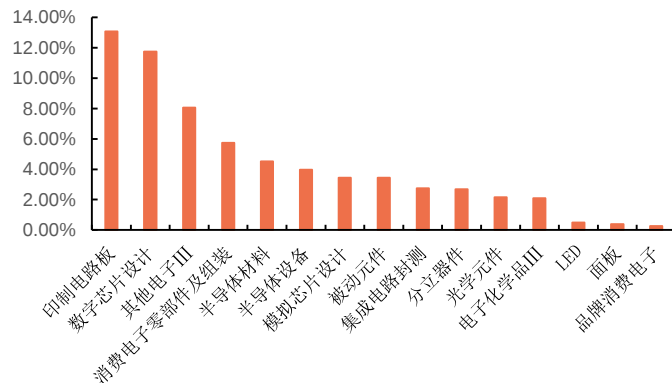
资料来源：wind，申港证券研究所

图3：申万一级行业年初至今涨跌幅

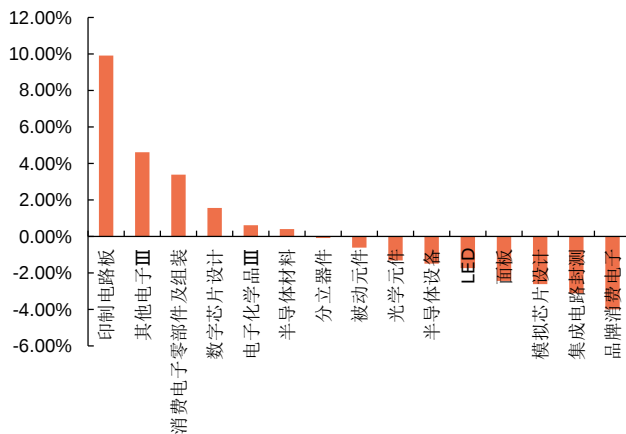


资料来源：wind，申港证券研究所

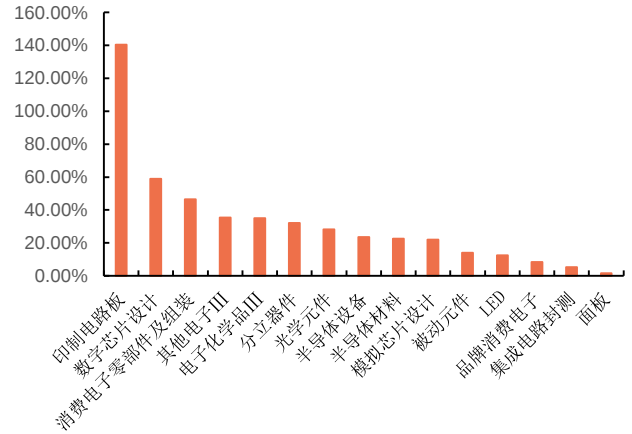
上周(9.8-9.12)申万电子行业三级子行业中印制电路板、数字芯片设计、其他电子Ⅲ、消费电子零部件及组装、半导体材料指数涨跌表现相对靠前,分别跑赢沪深300指数11.69%、10.37%、6.68%、4.35%、3.13%。

图4: 电子子行业上周涨跌幅


资料来源: wind, 申港证券研究所

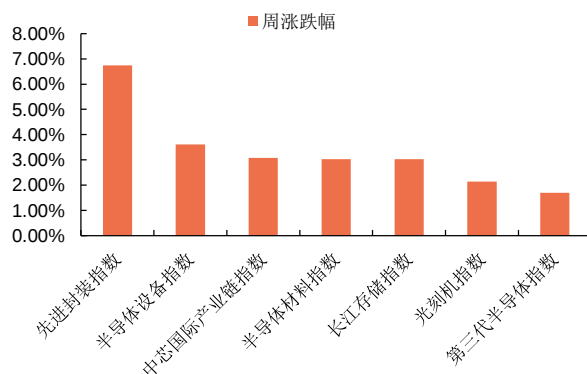
图5: 电子子行业本月涨跌幅


资料来源: wind, 申港证券研究所

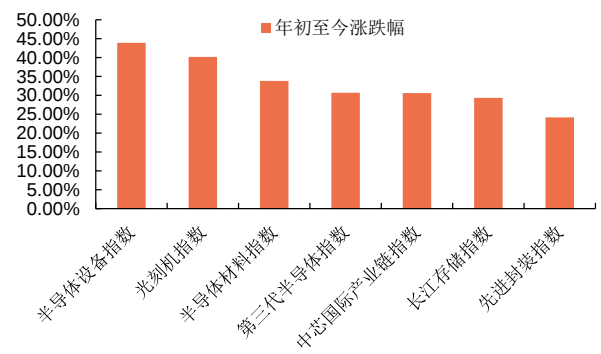
图6: 电子子行业年初至今涨跌幅


资料来源: wind, 申港证券研究所

上周(9.8-9.12)万得半导体概念指数中先进封装指数、半导体设备指数、中芯国际产业链指数、半导体材料指数、长江存储指数、光刻机指数、第三代半导体指数涨跌幅分别为6.74%、3.61%、3.07%、3.03%、3.02%、2.14%、1.69%。

图7: 万得半导体概念指数上周涨跌幅


资料来源: wind, 申港证券研究所

图8: 万得半导体概念指数年初至今涨跌幅


资料来源: wind, 申港证券研究所

截至9月12日，费城半导体指数收于6001.74点、周上涨4.17%。台湾半导体指数收于747.86点、周上涨5.92%。

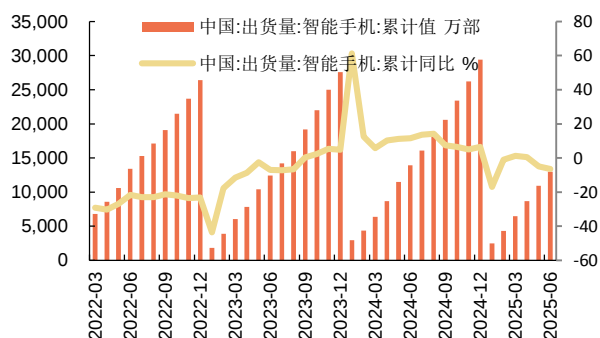
图9：费城半导体指数


资料来源：wind，申港证券研究所

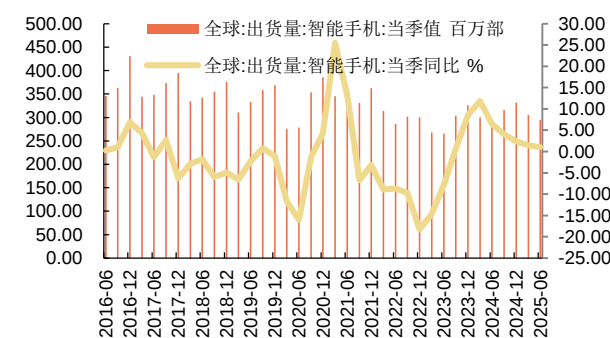
图10：台湾半导体指数


资料来源：wind，申港证券研究所

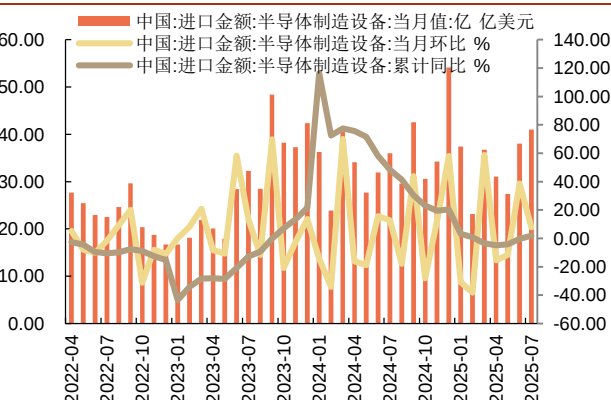
2. 行业数据跟踪

图11：中国智能手机出货量及累计同比


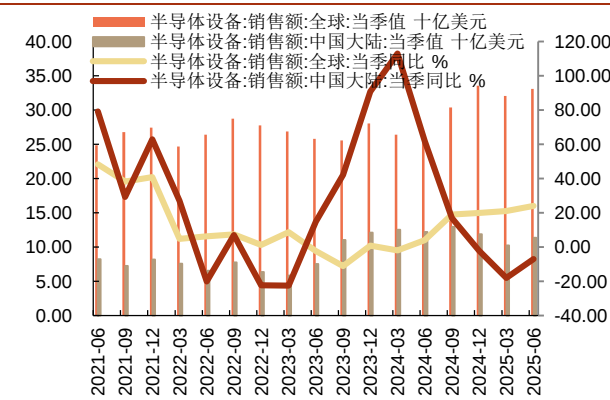
资料来源：wind，申港证券研究所

图12：全球智能手机出货量及当季同比


资料来源：wind，申港证券研究所

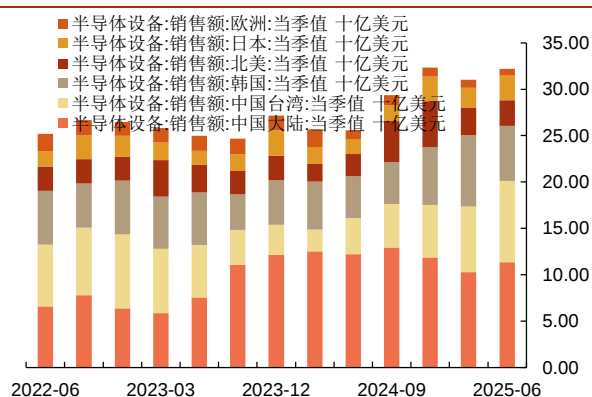
图13：中国进口半导体制造设备金额及环比情况


资料来源：wind，申港证券研究所

图14：全球及中国大陆半导体设备销售额及同比


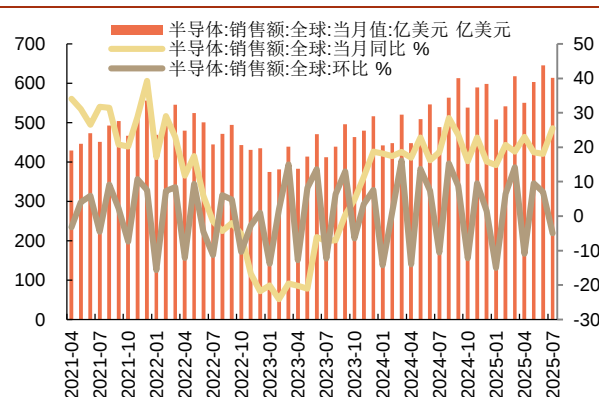
资料来源：ifind，申港证券研究所

图15：主要地区半导体设备销售额



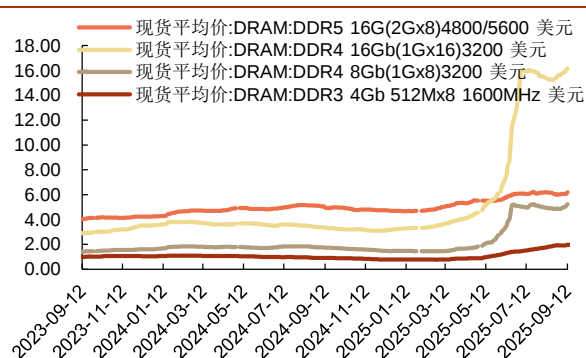
资料来源：ifind，申港证券研究所

图16：全球半导体销售额及同环比情况



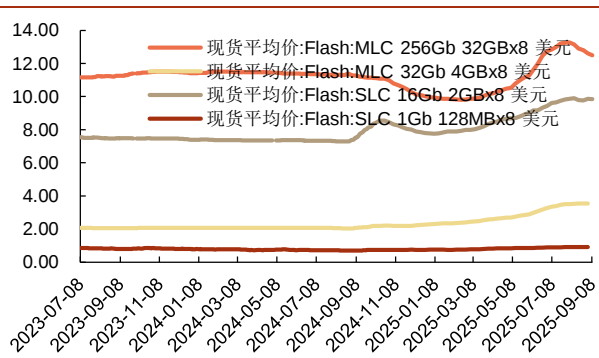
资料来源：ifind，申港证券研究所

图17：DRAM 现货平均价



资料来源：ifind，申港证券研究所

图18：NAND Flash 现货平均价



资料来源：ifind，申港证券研究所

3. 每周一谈：商务部就美国模拟芯片发起反倾销调查 拓荆科

技公告增资加码后端设备

商务部就美国模拟芯片发起反倾销调查，复苏背景下国产替代有望加速。根据商务部和财联社消息，商务部公告对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销调查，涉及自美进口的使用 40nm 及以上工艺制程的通用接口和栅极驱动芯片。申请人提交的初步证据显示，2022-2024 年，申请调查产品自美进口量累计增长 37%，进口价格累计下降 52%，压低和抑制了国内产品销售价格，对国内产业的生产经营造成

损害。据江苏省半导体行业协会提交的申请文件，相关美国生产商包括四家，分别是德州仪器、ADI、博通、安森美。初步证据显示，申请调查期内，原产于美国的申请调查产品的价格持续大幅下降，对华出口的倾销幅度高达 300% 以上。Wind 数据显示，德州仪器（TI）2022-2024 年中国区营收额呈下降趋势，2024 年中国区营收占比 19% 达到 30.12 亿美元。亚德诺（ADI）2024 年中国区域营收较 2023 年下降 5% 达到 21.29 亿美元，两公司 2024 年合计营收超过 51 亿美元。根据半导体产业纵横及其援引 WSTS 等数据，2024 年全球模拟 IC 市场规模约 794 亿美元，中国市场规模占比近半壁江山。从进口量来看，本次申请调查产品的合计进口数量呈持续大幅上升趋势，2022-2024 年，合计进口数量分别为 11.59、12.99 和 15.90 亿颗，国产替代空间广阔。

与非网 eefocus 数据显示，2024 年中国模拟 IC 市场规模约 1953 亿元，其中 TI 和 ADI 在华营收占比 14.6%，而国内厂商合计仅不足 7%，在车规模拟 IC 市场差距更为悬殊。近年来国产模拟芯片在 ADC（模数转换器）领域等频频实现技术突破，通过并购整合来完善产品线，积极打造平台化战略。中芯国际 Q2 业绩交流表示，二季度模拟芯片需求增长显著，广泛应用于手机快充、电源管理等领域的模拟芯片正处于国产加速替代阶段。根据半导体产业纵横统计，2025 年上半年模拟芯片行业毛利率整体呈改善态势，行业盈利能力稳步增强，2025 年多数模拟芯片企业的库存周转天数较同期呈现明显的缩短趋势。我们认为，模拟芯片供应链国产化能力较好，市场国内需求广阔，随着国产在车规、工业等中高端市场的点上突破及企业并购整合进程，国产化率有望加速提升。

拓荆科技公告增资拓荆键科，大基金三期同步投资，着力键合等半导体后端设备突破。上周拓荆科技发布公告，为进一步推动控股子公司拓荆键科在三维集成设备领域的迅速发展，联合国投集新等增资拓荆键科不超过 10.395 亿元。拓荆键科主要聚焦三维集成领域先进键合设备（包括混合键合、熔融键合设备）及配套使用的量检测设备，已先后推出了晶圆对晶圆混合键合设备、晶圆对晶圆熔融键合设备、芯片对晶圆键合前表面预处理设备、芯片对晶圆混合键合设备、键合套准精度量测产品、键合套准精度量测设备、永久键合后晶圆激光剥离设备等产品。目前该公司产品已出货至先进存储、逻辑、图像传感器等客户。根据科创板日报，国投集新基金重要出资人为大基金三期，对拓荆键科的投资，是大基金三期成立至今首度出手半导体产业项目。根据半导体行业观察援引 Yole 数据显示，2020 全球混合键合设备市场规模达 3.2 亿美元，预计 2027 年 CoW(D2W)/WoW(W2W) 市场规模将分别攀升至 2.3 亿/5.1 亿美元，CAGR 高达 69%/16%，凸显该领域强劲增长潜力。

我国半导体设备国产化率相对偏低，根据 EEPW，2024 年除去胶设备、清洗设备、刻蚀设备和热处理设备国产化率超 30% 外，PVD/CVD/ALD、CMP、涂胶显影、离子注入、量检测和光刻等环节的国产化率仍低于 20%，分别为 5-20%、30-40%、5-10%、10-20%、1-10% 和 0-1%。过去国内半导体设备国产化的主要方向聚焦于晶圆制造领域，目前先进封装等后端设备在芯片制造中扮演的角色日益重要，根据 PanSemicon 援引 Yole Group 数据，2025 年后端设备总收入约为 69 亿美元，预计到 2030 年将增长至 92 亿美元，复合年增长率为 5.8%，目前国内供应商仅满足不到 14% 的内部后端设备需求。

我国在键合设备和量检测设备国产化率较低，我们认为本次增资或助力国产设备在关键环节的突破和提升。

图19：后端设备总收入有望由 2025 年约 69 亿美元增长至 2030 年的 92 亿美元，复合年增长率达 5.8%



资料来源：Yole Group, PanSemicon, 申港证券研究所

4. 重要公告

芯原股份：9月12日发布关于新签订单的自愿性披露公告。截至2025年第二季度末，公司在手订单金额为30.25亿元，已连续七个季度保持高位，创公司历史新高。2025年7月1日至2025年9月11日，公司新签订单12.05亿元，较去年第三季度全期大幅增长85.88%，新签订单已创历史新高，其中AI算力相关的订单占比约64%。除新签订单创历史新高外，公司在手订单持续保持高位，预计将对公司后续经营业绩产生深远的影响。

闻泰科技：9月10日发布关于重大资产出售的进展公告。截至本公告披露日，本次交易标的资产的各项交割工作正在推进过程中，其中昆明智通、深圳闻泰、黄石智通、昆明闻讯股权已经交割；无锡闻泰、无锡闻讯相关业务资产包已经交割；印度闻泰相关业务资产包资产已完成转移，部分资产权属变更手续尚在办理过程中；香港闻泰及其子公司印尼闻泰的股权交割，拟在完成相关非交易范围资产的剥离工作后实施。

中芯国际：9月9日发布发行股份购买资产暨关联交易预案。上市公司拟向国家集成电路基金等5名中芯北方股东发行股份购买其所持有的标的公司49.00%股权。发行价格74.20元/股，不低于定价基准日前120个交易日的上市公司A股股票交

易均价 92.75 元/股的 80%。

拓荆科技: 9 月 13 日发布 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案。公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票, 采取竞价发行方式, 定价基准日为发行期首日, 发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%, 数量不超过本次发行前公司总股本的 30%, 即 83,918,735 股 (含本数)。募集资金总额不超过人民币 460,000.00 万元 (含本数), 扣除发行费用后拟投入高端半导体设备产业化基地建设项目、前沿技术研发中心建设项目、补充流动资金。其中“高端半导体设备产业化基地建设项目”系公司使用首次公开发行募集资金 26,826.60 万元投资的项目, 公司拟使用本次募集资金 150,000.00 万元对其进行追加投资。

拓荆科技: 9 月 13 日发布关于向控股子公司增资暨关联交易的公告。根据公司发展战略规划, 为进一步推动控股子公司拓荆键科在三维集成设备领域的迅速发展, 拓荆键科本次拟融资共计不超过人民币 103,950.00 万元。公司拟以不超过人民币 45,000.00 万元认缴, 交易完成后, 公司对拓荆键科的出资额占本次增资后拓荆键科注册资本的比例约为 53.5719%。国投集新占比约为 12.7137%, 展昀禾及展昀启占比约为 2.8252%, 华虹产投占比约 0.8476%, 海宁融创占比约为 0.2684%。

扬杰科技: 9 月 12 日发布关于现金收购东莞市贝特电子科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告。公司拟支付现金购买东莞市贝特电子 100% 股权, 最终确定整体转让价格为人民币 221,800 万元。本次交易完成后, 贝特电子将成为上市公司的全资子公司。本次交易设置业绩承诺, 业绩承诺方承诺 2025 年-2027 年标的公司应实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于 5.55 亿元。本次交易标的公司股东全部权益在评估基准日的评估价值 222,000.00 万元, 与母公司报表口径中股东全部权益账面价值 59,924.80 万元相比, 评估增值 162,075.20 万元, 增值率为 270.46%; 与合并报表口径归属于母公司的股东权益账面价值 57,980.33 万元相比, 评估增值 164,019.67 万元, 增值率为 282.89%。

5. 行业动态

注册资本 207.2 亿元, 长江存储三期工程或将启动

9 月 8 日消息, 长存三期 (武汉) 集成电路有限责任公司 (以下简称“长存三期”) 成立于 9 月 5 日, 注册资本 207.2 亿元, 大股东为长江存储科技有限责任公司 (以下简称“长江存储”), 法定代表人为长江存储董事长陈南翔。

根据企查查资料显示, 长存三期经营范围包括集成电路制造、集成电路销售、集成电路设计、集成电路芯片及产品销售等。

股东信息显示, 长存三期由长江存储持股 50.19%、湖北长晟三期投资发展有限责任公司持股 49.81%。其中, 湖北长晟三期投资发展有限责任公司为湖北国资旗下企业, 这一背景为新公司提供了坚实的资本与政策支持。显然, 此举将利好国产存

储产业，也利好国产半导体设备产业。（来源：芯智讯）

传美国将向三星和 SK 海力士在华晶圆厂颁发年度许可证

9 月 8 日消息，据彭博社报道，继美国政府撤销对三星及 SK 海力士在华晶圆厂的经验证最终用户（VEU）授权之后，美国政府正考虑将对三星和 SK 海力士在华原厂的出口许可更改为年度许可，此举虽然将增加监管的复杂性，但至少可以保持它们晶圆厂运营的连续性，避免 DRAM 和 NAND 存储器供应中断风险。（来源：芯智讯）

三星将向英伟达大量供应 GDDR7，或用于对华特供的 B30 芯片

9 月 8 日消息，据韩国媒体 ETnews 报道，三星电子将大规模向英伟达供应第七代显存（GDDR7），据传英伟达下单量已较此前增加了一倍，三星为此也完成了扩产准备，最快本月启动新产线。业界普遍认为，这批 GDDR7 将应用于英伟达针对中国市场设计的 AI 加速器。报道称，目前，三星量产 GDDR7 的所有准备工作已经完成，扩充后的供应链计划最早于本月开始运营。一位知情人士表示，“三星已应英伟达的要求完成扩建”，“量产迫在眉睫”。

不过，英伟达从三星电子订购的 GDDR7 规格和规模尚未得到具体确认，不过预计最低可达数千亿韩元，最高可达数万亿韩元。据悉，仅英伟达 GDDR7 的基板需求量就约为 2000 亿韩元。摩根士丹利预计今年 B30 的出货量将达到 100 万颗。市场研究公司 TrendForce 研究员 Frank Kung 表示，“如果地缘政治不确定性持续存在，B30 可能成为中国市场的主要替代品。（来源：芯智讯）

库存调整结束，2Q25 全球智能手机生产总数达 3 亿支，季增约 4%

根据 TrendForce 集邦咨询最新调查，2025 年第二季智能手机产量受季节性需求带动，加乘 Oppo、Transsion（传音）等品牌历经库存调整后恢复生产动能，全球智能手机生产总数达 3 亿支，季增约 4%，年增亦有 4.8%。尽管后续经济形势依然抑制消费型产品买气，但下半年传统旺季、电商促销等因素，将有助产量维持全年逐季增长格局。

TrendForce 集邦咨询表示，第一季中国市场的智能手机补贴政策短期刺激中低端产品销量，并促进库存去化，然因补贴金额、覆盖商品受限，预估对 2025 全年的销售帮助也有限。（来源：TrendForce 集邦）

英伟达突然发布新 GPU，单机架 AI 性能暴涨 650%，100TB 大内存，专攻长上下文推理

芯东西 9 月 10 日报道，昨晚，英伟达又放 AI 计算大招，推出专为长上下文推理和视频生成应用设计的新型专用 GPU——NVIDIA Rubin CPX。英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋说：“正如 RTX 彻底改变了图形和物理 AI 一样，Rubin CPX 是首款专为海量上下文 AI 打造的 CUDA GPU，这种 AI 模型可以同时处理数百万个知识 token 的推理。” Rubin CPX 配备 128GB GDDR7 内存，NVFP4 精度下 AI 算力可达 30PFLOPS，非常适合运行长上下文处理（超过 100 万个 token）和视频生成任务。Vera Rubin NVL144 CPX 平台可在单机架集成 144 张 Rubin CPX GPU、144 张 Rubin GPU、36 张 Vera CPU，提供 8EFLOPS 的 AI 性能（NVFP4 精度）和 100TB

的快速内存，内存带宽达到 1.7PB/s。

其 AI 性能是英伟达 Vera Rubin NVL144 平台的 2 倍多，是基于 Blackwell Ultra 的 GB300 NVL72 系统的 7.5 倍，相比 GB300 NVL72 系统还能提供 3 倍更快的注意力机制。Rubin CPX GPU 预计将于 2026 年底上市。（来源：芯东西）

芯原拟 100%控股芯来：股份发行价 106.66 元/股

9 月 11 日晚间，国产半导体 IP 及一站式芯片定制服务厂商芯原股份正式公布了发行股份及支付现金的方式购买芯来智融半导体科技（上海）有限公司（以下简称“芯来智融”或“标的公司”）股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的预案。芯原股份称，本次交易为上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向芯来共创、胡振波、芯来合创等 31 名交易对方购买其合计持有的芯来科技 97.0070% 股权，并募集配套资金。截至本预案签署日，上市公司直接持有芯来科技 2.9930% 股权，本次交易完成后，芯来科技将成为上市公司的全资子公司。（来源：芯智讯）

反倾销落地，国产模拟芯片迎转机

商务部连发两条公告，公布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查、就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。

商务部新闻发言人就对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销调查答记者问时表示，此次反倾销调查是应中国国内产业申请发起，符合中国法律法规和世贸组织规则。调查涉及自美进口的通用接口和栅极驱动芯片。申请人提交的初步证据显示，2022 至 2024 年，申请调查产品自美进口量累计增长 37%，进口价格累计下降 52%，压低和抑制了国内产品销售价格，对国内产业的生产经营造成损害。（来源：半导体产业纵横）

AI 芯片需求旺盛，台积电 8 月营收激增 34%

台积电 9 月 10 日公布最新营收报告，8 月合并营收约为 3357.72 亿元新台币，较上月增加了 3.9%，较去年同期增加了 33.8%，创单月历史次高以及历年同期新高，表明全球对尖端 AI 硅片的需求持续增长。

台积电累计 2025 年 1 至 8 月营收约为 24319.83 亿元新台币，较去年同期增加了 37.1%。台积电是后 ChatGPT 时代人工智能热潮的最大受益者之一，因为它在英伟达加速器的生产中发挥着核心作用。台积电也是全球最大的最先进芯片生产商，其芯片为苹果公司的 iPhone 提供芯片。（来源：集微网）

HBF 即将崛起，与 HBM 并行发展

9 月 11 日消息，据韩国媒体 Thelec 报导，韩国科学技术院（KAIST）电机工程系教授 Kim Joung-ho（在韩国媒体中被誉为“HBM 之父”）表示，高带宽闪存（High Bandwidth Flash, HBF）有望成为下一代 AI 时代的重要存储技术，将与高带宽内存（HBM）并行发展，共同推动芯片大厂的业绩成长。HBF 的设计概念与 HBM 相似，均通过硅通孔（TSV）技术将多层芯片堆叠连接。差别在于 HBM 以 DRAM 为核心，而 HBF 则采用 NAND Flash 闪存进行堆栈，具备“容量更大、成本更具优势”的特点。

Kim Joung-ho 强调，这种限制来自现行的冯诺依曼架构，由于 GPU 与内存是分离设计，数据传输带宽决定了效能上限，“即便将 GPU 规模扩大一倍，如果带宽不足也毫无意义”。他预测，未来 GPU 将同时搭载 HBM 与 HBF，形成互补架构：HBM 做为高速快取，负责即时运算数据，而 HBF 则承担大容量储存，直接存放完整的 AI 模型。这将有助于突破存储瓶颈，使 GPU 能处理更庞大的生成式 AI，甚至涵盖长篇视频等复杂内容。Kim Joung-ho 表示：“未来 AI 将不仅限于文字与图像，而能生成如电影般的长片，届时所需的内存容量将是现有的 1,000 倍以上。”

之前也有消息显示，存储芯片大厂 Sandisk 正在联手 SK 海力士开发用于 AI 系统的 HBF 规范。HBF 能够以与 DRAM 型 HBM 相当的成本和带宽，提供高达 DRAM 型 HBM 约 8 到 16 倍的容量。并且，与需要恒定功率来保存数据的 DRAM 不同，NAND 是非易失性的，因此能够以更低的能耗实现持久存储。

Sandisk 的目标是在 2026 年下半年交付其 HBF 闪存的第一批样品，首款集成该技术的 AI 推理硬件预计将于 2027 年初推出。（来源：芯智讯）

传美光 DRAM 暂停报价，预计将涨价 30%

随着 AI 应用从“训练”向“推理”及边缘设备延伸，带动大容量 DRAM 内存需求持续增长，导致内存供应吃紧。据台媒《经济日报》援引业内传闻报道称，全球第三大存储芯片厂商美光将暂停对渠道商及 OEM/ODM 厂商报价，后续价格可能调涨 20%-30%。供应链消息称，美光已通知客户，包括 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等内存产品全部停止报价，规划停止报价一周，且相关产品价格可能调涨 20%-30%。这也是继上周 SanDisk 将 NAND Flash 报价上调 10% 后，又一家存储芯片厂商对旗下产品涨价。据了解，此次涨价涉及的不仅是消费级与工业级内存产品，汽车电子内存产品涨幅更高，预计最高可达 70%。供应链表示，美光高层观察到客户的 FCST（需求预测）显示重大的供应短缺，因此紧急暂停所有产品报价，将重新调整后价格。（来源：芯智讯）

紫光国微：已成功推出并量产多款符合国内通信标准的 eSIM 产品

大半导体产业网消息，日前，紫光国微在投资者互动平台表示，作为国内首家实现 eSIM 全球商用的芯片商，公司已成功推出并量产多款符合 GSMA 及国内通信标准的 eSIM 产品，并专门针对“AI+5G+eSIM”融合应用新场景完成了技术布局与产品储备，且根据市场需求预测做了相应备货。紫光国微在上月举行的 2025 半年度业绩说明会上曾表示，其 eSIM 芯片产品在全球范围内已具备批量出货能力，若国内 eSIM 政策开放，国内手机市场将成关键增长点。此外，相较于手机端 eSIM 芯片，车载 eSIM 整体市场使用规模远低于手机端。但是近年来受汽车行业市场竞争加剧的影响，车规级产品的定价策略逐步调整，目前与手机端等消费级产品的价格差距已收窄。（来源：SEMI）

6. 风险提示

贸易摩擦加剧，需求复苏不及预期，产能扩张不及预期，竞争加剧

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人独立研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处，不受任何第三方的影响和授意。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

免责声明

申港证券股份有限公司（简称“本公司”）是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性和完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。

申港证券研究所已力求报告内容的客观、公正，但报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价，不构成其他投资标的的要约和邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。投资者不应单纯依靠本报告而取代自身独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载资料、意见及推测仅反映申港证券研究所于发布本报告当日的判断，本报告所指证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会产生波动，在不同时期，申港证券研究所可能会对相关的分析意见及推测做出更改。本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。

本报告仅面向申港证券客户中的专业投资者及风险承受能力为 C3、C4、C5 的普通投资者，本公司不会因接收人收到本报告而视其为当然客户。本报告版权归本公司所有，未经事先许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如转载或引用，需注明出处为申港证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、发布、转载和引用者承担。

投资评级说明

申港证券行业评级说明：增持、中性、减持

增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5% 以上
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上

（基准指数说明：A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为标普 500 指数或纳斯达克指数。）

申港证券公司评级说明：买入、增持、中性、减持

买入	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 15% 以上
增持	报告日后的 6 个月内，相对强于市场基准指数收益率 5%~15% 之间
中性	报告日后的 6 个月内，相对于市场基准指数收益率介于 -5%~+5% 之间
减持	报告日后的 6 个月内，相对弱于市场基准指数收益率 5% 以上

（基准指数说明：A 股市场基准为沪深 300 指数；香港市场基准为恒生指数；美国市场基准为标普 500 指数或纳斯达克指数。）